

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。由於這僅為概要，故並不包含可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下在決定投資[編纂]前應閱讀本文件全文。任何投資均涉及風險，有關投資[編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定投資[編纂]前應仔細閱讀該節。

概覽

我們是一家領先的芯片設計公司，專注於BLDC電機驅動控制芯片的設計與研發，並在業界建立強大的市場地位。BLDC電機是一種採用電子換向方式驅動的無刷電機，其通過電子換向實現磁場的變化，驅動電機轉子旋轉。根據弗若斯特沙利文的資料，與傳統電機相比，BLDC電機具有效率高、功耗低、控制精度高、噪音低等優點，在各類應用領域得到廣泛使用。我們的產品旨在幫助最大發揮BLDC電機的性能優勢，實現高效率、低噪音、高精度的運行表現。根據弗若斯特沙利文的資料，我們的產品涵蓋典型電機驅動控制系統的全部核心器件，包括(i)電機主控芯片，如MCU和ASIC；(ii)電機驅動芯片，如HVIC；(iii)智能功率模塊IPM；及(iv)功率器件，如MOSFET。根據弗若斯特沙利文的資料：

- 我們是中國首家專注於BLDC電機驅動控制芯片設計的芯片廠商；
- 我們是全球首家實現基於FOC算法硬件化的電機主控專用芯片大規模量產的芯片廠商；及
- 截至2023年12月31日，我們在中國BLDC電機主控及驅動芯片市場的份額達到4.8%(按收入計)，排名第六，且我們為該市場前十大企業中唯一的中國企業。

我們專攻(i)芯片設計、(ii)電機驅動架構算法及(iii)電機技術三大核心技術領域的研發工作，已在該等領域實現多項具競爭力的技術。三大技術領域的結合，形成了我們在電機驅動控制芯片領域的核心競爭力。根據弗若斯特沙利文的資料，我們是中國首家同時具備三重技術團隊的電機驅動控制芯片廠商。

概 要

我們的主要產品包括MCU/ASIC、HVIC、MOSFET以及IPM，均為典型BLDC電機驅動控制系統的核心組件。其中，MCU/ASIC作為電機主控芯片，負責接收電子信號、執行電機驅動架構算法及生成控制指令；HVIC作為驅動芯片，起到高低壓隔離和增大驅動能力的的作用，使MCU/ASIC能夠驅動MOSFET器件；MOSFET根據MCU/ASIC的控制指令，在HVIC的驅動下，產生特定的電磁場，實現電機的運轉，使BLDC電機高效運行。有關詳情，請參閱「業務－我們的產品－概覽」。此外，我們還提供IPM模塊，其可將MCU/ASIC、HVIC及／或MOSFET合封在一起，從而減少外部器件數量及縮小PCB面積，簡化了電機驅動控制系統設計，為客戶提供簡單高效的解決方案。

我們的產品用於BLDC電機，而BLDC電機已廣泛應用於多個下游領域，包括智能小家電、白色家電、電動工具、運動出行、工業及汽車應用。我們憑借紮實的研發實力、可靠的產品質量和高性價比優勢，積累了廣泛的優質終端客戶資源。

憑藉我們在芯片設計、電機驅動架構算法及電機技術三大領域的協同效應，我們擁有向終端客戶提供系統級服務及解決應用層面的技術難題的能力。我們的芯片設計、電機驅動架構算法及電機技術研發團隊與終端客戶密切溝通合作，並提供全面的系統級服務。透過這個過程，我們也收集有關下游市場需求的信息，並在我們的研發及技術提升中加以考慮。

我們的競爭優勢

我們相信以下優勢能讓我們很好地把握未來機會，實現持續增長：(i)電機驅動控制前沿技術引領者，自主研發開創性的ME內核；(ii)芯片設計、電機驅動架構算法、電機技術三重技術協同，具備提供系統級服務的能力；(iii)高可靠性產品，具備快速迭代、多應用領域延展和大規模產業化能力；(iv)廣泛服務優質終端客戶，構築高粘性合作關係；及(v)具有深厚芯片研發經驗的複合型團隊。

我們的增長戰略

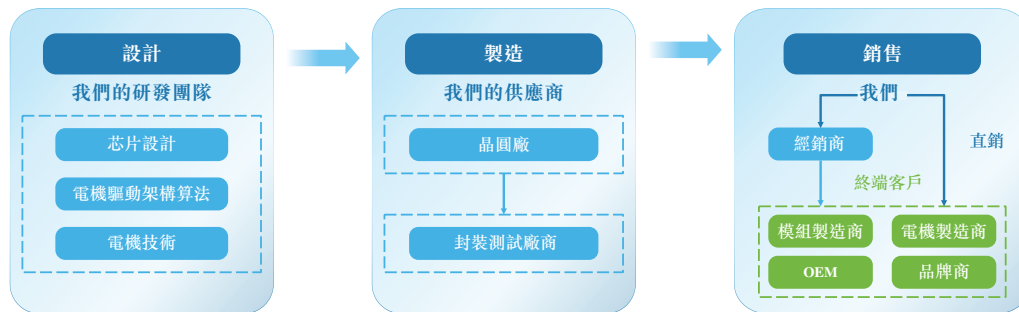
我們計劃採取以下戰略：(i)持續投入研發，鞏固並增強技術優勢；(ii)鞏固消費級應用領域優勢，攜手戰略夥伴把握產業升級契機；(iii)全面佈局工業、汽車等新興應用領域，擁抱戰略新興產業；(iv)拓展海外市場，推動產品走向全球，以國際化視野開展產業佈局；及(v)吸引全球頂尖人才，持續打造人才梯隊。

概 要

我們的FABLESS經營模式

我們採用fabless模式，專注於我們產品的設計及研發，而將晶圓製造、芯片封裝測試外包給值得信賴的第三方合作夥伴。根據弗若斯特沙利文的資料，fabless經營模式符合半導體行業專業化分工日益增強的趨勢，採用fabless模式的公司可集中精力及資源於設計及研發。

下圖說明我們的fabless經營模式：



我們的客戶及供應商

於往績記錄期，我們的客戶主要包括經銷商。於2022年、2023年及截至2024年9月30日止九個月，我們的前五大客戶合共產生收入分別為人民幣182.7百萬元、人民幣208.3百萬元及人民幣205.5百萬元，分別佔我們總收入的56.6%、50.6%及47.5%。於往績記錄期各個期間，來自我們的最大客戶的收入分別佔我們總收入的20.9%、17.5%及15.0%。有關更多詳情，請參閱「業務－我們的客戶」。

於往績記錄期，我們的供應商主要包括(i)晶圓廠；及(ii)提供芯片封裝測試服務的廠商。我們通常委聘信譽良好的供應商以確保我們的產品質量。於2022年、2023年及截至2024年9月30日止九個月，我們向前五大供應商採購的金額分別為人民幣209.8百萬元、人民幣182.2百萬元及人民幣160.3百萬元，分別佔我們採購總額的89.3%、86.9%及79.6%。此外，我們向最大供應商採購的金額分別佔我們於2022年、2023年及截至2024年9月30日止九個月的採購總額的52.4%、62.8%及32.9%。有關更多詳情，請參閱「業務－我們的供應商」。

概 要

競爭格局

我們經營所在的行業競爭激烈，對創新及高效產品的需求日益增加。我們與從事BLDC電機主控及驅動芯片設計及生產的海外及國內公司競爭。我們的競爭主要圍繞產品性能、技術創新、成本效益及市場反應。根據弗若斯特沙利文的資料，外國公司在市場上保持主導地位。然而，中國公司憑藉技術創新能力實現快速增長。這些公司在策略上專注於特定的市場領域，逐步提高市場佔有率，並實現國內替代，有效滿足這些領域的需求及要求。於2023年，我們在中國BLDC電機主控及驅動芯片市場中排名第六，且是該市場前十大公司中唯一的中國公司。我們繼續專注於利用我們的技術專長、以客戶為中心的解決方案及營運效率，以維持及提升我們在市場上的地位。

歷史財務資料概要

綜合財務資料概要應與本文件附錄一會計師報告的綜合財務資料(包括隨附附註)及本文件「財務資料」所載資料一併閱讀。

概 要

綜合損益及綜合全面收益表概要

下表載列我們於所示年度的綜合損益及綜合全面收益表的主要項目：

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2023年		2024年	
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)
					(未經審計)			
收入	322,973	100.0	411,359	100.0	281,568	100.0	432,827	100.0
銷售成本	(137,774)	(42.7)	(192,678)	(46.8)	(132,325)	(47.0)	(206,838)	(47.8)
毛利	185,199	57.3	218,681	53.2	149,243	53.0	225,989	52.2
其他收入及收益	58,967	18.3	84,376	20.5	56,277	20.0	62,043	14.3
銷售及經銷開支	(12,605)	(3.9)	(18,396)	(4.5)	(11,989)	(4.3)	(13,020)	(3.0)
行政開支	(24,543)	(7.6)	(27,193)	(6.6)	(18,487)	(6.6)	(20,353)	(4.7)
研發開支	(63,845)	(19.8)	(84,674)	(20.6)	(52,007)	(18.5)	(65,079)	(15.0)
金融資產減值虧損淨額	35	0.0	(143)	(0.0)	(112)	(0.0)	91	0.0
其他開支	(2)	(0.0)	(1,780)	(0.4)	(4)	(0.0)	(3,963)	(0.9)
融資成本	(62)	(0.0)	(490)	(0.1)	(395)	(0.1)	(396)	(0.1)
除稅前利潤	143,144	44.3	170,381	41.4	122,526	43.5	185,312	42.8
所得稅(開支)/抵免	(1,143)	(0.4)	4,466	1.1	1,481	0.5	(1,500)	(0.3)
年/期內利潤	<u>142,001</u>	<u>44.0</u>	<u>174,847</u>	<u>42.5</u>	<u>124,007</u>	<u>44.0</u>	<u>183,812</u>	<u>42.5</u>
其他綜合收益/(虧損)	<u>320</u>	<u>0.1</u>	<u>(1,087)</u>	<u>(0.3)</u>	<u>(54)</u>	<u>(0.0)</u>	<u>(298)</u>	<u>(0.1)</u>
年/期內綜合收益/(虧損)								
總額，扣除稅項	<u>142,321</u>	<u>44.1</u>	<u>173,760</u>	<u>42.2</u>	<u>123,953</u>	<u>44.0</u>	<u>183,514</u>	<u>42.4</u>

概 要

收入

下表載列我們於所示期間按產品劃分的收入及佔總收入的百分比明細：

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2023年		2024年	
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元 (未經審計)	(%)	人民幣千元 (未經審計)	(%)
MCU	232,343	71.9	274,748	66.8	187,482	66.6	276,536	63.9
ASIC	19,697	6.1	48,254	11.7	34,123	12.1	58,526	13.5
HVIC	56,261	17.4	66,395	16.1	46,424	16.5	65,368	15.1
MOSFET	7,828	2.4	3,655	0.9	2,725	1.0	1,518	0.4
IPM	4,751	1.5	16,929	4.1	9,755	3.5	30,061	6.9
其他 ⁽¹⁾	2,093	0.6	1,378	0.3	1,059	0.4	818	0.2
總計	<u>322,973</u>	<u>100.0</u>	<u>411,359</u>	<u>100.0</u>	<u>281,568</u>	<u>100.0</u>	<u>432,827</u>	<u>100.0</u>

附註：

(1) 其他主要包括銷售其他產品(包括半導體DEMO板及仿真器等)的收入。

毛利及毛利率

下表載列我們於所示期間按產品劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2023年		2024年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元 (未經審計)	(%)	人民幣千元 (未經審計)	(%)
銷售產品								
MCU	142,002	61.1	155,703	56.7	107,159	57.2	153,171	55.4
ASIC	11,931	60.6	25,303	52.4	17,371	50.9	34,491	58.9
HVIC	26,326	46.8	29,110	43.8	19,807	42.7	26,831	41.0
MOSFET	1,549	19.8	998	27.3	658	24.1	584	38.5
IPM	1,775	37.4	7,777	45.9	4,368	44.8	13,445	44.7
其他 ⁽¹⁾	1,868	89.2	1,076	78.1	840	79.3	602	73.6
小計	<u>185,451</u>	<u>57.4</u>	<u>219,967</u>	<u>53.5</u>	<u>150,203</u>	<u>53.3</u>	<u>229,124</u>	<u>52.9</u>
存貨減值	(252)		(1,286)		(960)		(3,135)	
總計	<u>185,199</u>	<u>57.3</u>	<u>218,681</u>	<u>53.2</u>	<u>149,243</u>	<u>53.0</u>	<u>225,989</u>	<u>52.2</u>

附註：

(1) 其他主要包括銷售其他產品(包括半導體DEMO板及仿真器等)的毛利。

概 要

綜合財務狀況報表概要

	截至12月31日		截至9月30日
	2022年	2023年	2024年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審計)
非流動資產總額	145,048	523,242	1,138,112
流動資產總額	<u>2,227,883</u>	<u>1,970,446</u>	<u>1,417,403</u>
總資產	<u>2,372,931</u>	<u>2,493,688</u>	<u>2,555,515</u>
非流動負債總額	27,232	9,591	4,922
流動負債總額	<u>90,640</u>	<u>92,979</u>	<u>45,594</u>
總負債	<u>117,872</u>	<u>102,570</u>	<u>50,516</u>
資產淨值	<u>2,255,059</u>	<u>2,391,118</u>	<u>2,504,999</u>
股本	92,363	92,363	92,363
庫存股	—	—	(193)
儲備	<u>2,162,696</u>	<u>2,298,755</u>	<u>2,412,829</u>
權益總額	<u>2,255,059</u>	<u>2,391,118</u>	<u>2,504,999</u>

概 要

綜合現金流量表概要

下表載列我們於所示年度的現金流量選定資料：

	截至12月31日止年度		截至9月30日止九個月	
	2022年 人民幣千元	2023年 人民幣千元	2023年 人民幣千元 (未經審計)	2024年 人民幣千元 (未經審計)
經營活動所得現金流量淨額	34,833	111,343	65,967	120,095
投資活動(所用)／所得現金 流量淨額	(1,586,008)	28,061	(328,789)	(439,258)
融資活動所得／(所用)現金 流量淨額	1,677,946	(49,244)	(48,109)	(82,147)
現金及現金等價物增加／ (減少)淨額	126,771	90,160	(310,931)	(401,310)
年初的現金及現金等價物	391,773	519,585	519,585	608,696
匯率變動影響，淨額	1,041	(1,049)	130	(54)
年末的現金及現金等價物	519,585	608,696	208,784	207,332

概 要

主要財務比率

下表載列我們於所示日期或所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日或 截至該日止年度 2022年	2023年	截至9月30日 或截至該日 止九個月 2024年 (未經審計)
毛利率	57.3%	53.2%	52.2%
淨利潤率	44.0%	42.5%	42.5%
權益回報率 ⁽¹⁾	10.6%	7.5%	10.0%
資產總額回報率 ⁽²⁾	9.8%	7.2%	9.7%
流動比率 ⁽³⁾	24.6	21.2	31.1

附註：

- (1) 權益回報率乃按各年度的淨利潤或期間的年化淨利潤除以權益總額的期初及期末結餘的算術平均值再乘以100%計算。
- (2) 資產總額回報率乃按各年度淨利潤或期間的年化淨利潤除以資產總額的期初及期末結餘的算術平均值再乘以100%計算。
- (3) 流動比率乃按各年度／期間流動資產除以流動負債計算。

有關更多詳情，請參閱「財務資料－主要財務比率」。

風險因素

我們認為，我們的營運涉及若干風險與不確定性，其中有些風險與不確定性乃是我們無法控制。我們將該等風險與不確定性歸類為：(i)與我們的業務及行業有關的風險，(ii)與在我們經營所在的國家開展業務有關的風險及(iii)與[編纂]有關的風險。該等風險包括(其中包括)以下各項：

- 新的科技成果或趨勢可能會使我們的產品失去競爭力或過時。
- 我們依賴創始人、董事、高級管理層及其他關鍵員工(包括研發技術骨幹及技術工程師)的持續服務與表現。
- 我們的產品主要供若干行業及領域的終端客戶使用。對這些行業和領域造成不利影響的因素可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。
- 由於多種因素，我們經營所在的市場規模及對我們的產品需求可能無法如我們預期般快速增加，這將對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。

概 要

- 我們可能無法實施我們的預期增長計劃，而我們的業務及經營業績可能會受到不利影響。
- 我們經營所在的產業競爭激烈。如果我們無法與其他市場參與者競爭，我們的業務、經營業績及財務狀況可能會受到重大不利影響。
- 我們可能無法為我們的產品獲得或維持充分的知識產權保護，或該等知識產權保護的範圍可能不夠廣泛。
- 我們依賴少數第三方晶圓廠夥伴製造我們的產品。
- 我們透過我們的經銷網絡產生絕大部分收入。我們的經銷商的任何銷售減少或虧損均會對我們的業務、經營業績及財務狀況造成不利影響。
- 我們會受到半導體產業快速波動的影響。

法律訴訟及不合規情況

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規情況產生重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政訴訟(包括任何破產或接管程序)。有關更多詳情，請參閱「業務—法律訴訟及合規情況」。

我們的控股股東

截至最後實際可行日期，本公司(i)由峰昭香港持有38.06%權益，而峰昭香港由畢磊先生及其兄弟畢超博士控制大多數股權；及(ii)由芯運科技持有1.46%權益，而芯運科技由畢磊先生的配偶高帥女士全資擁有，分別佔本公司股東大會投票權的38.14%及1.47%(不包括本公司持作庫存股的193,000股A股)。畢磊先生、畢超博士及高帥女士訂立了一致行動協議，據此，彼等同意(其中包括)在本公司股東大會及董事會會議上投票時一致行動，直至2028年4月19日止。

因此，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無根據我們的限制性股票激勵計劃發行額外股份)，畢磊先生、畢超博士及高帥女士將透過峰昭香港及芯運科技共同有權於本公司股東大會上行使[編纂]%的投票權(不包括本公司持作庫存股的193,000股A股)。於[編纂]後，根據上市規則，畢磊先生、畢超博士、高帥女士、峰昭香港及芯運科技各自將構成我們的一組控股股東。有關詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」。

概 要

[編纂]統計數據

下表所載統計數據乃基於假設(i)[編纂]已完成及[編纂]中新發行[編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使；(iii)並無根據我們的限制性股票激勵計劃發行額外股份；及(iv)於[編纂]完成後已發行及發行在外[編纂]股股份：

	根據[編纂] 每股股份[編纂]港元	根據[編纂] 每股股份[編纂]港元
我們H股的市值 ⁽¹⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
每股未經審計[編纂]經調整綜合有形資產 淨值 ⁽²⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) 市值乃根據緊隨[編纂]完成後預計將有[編纂]股已發行H股的假設計算。
- (2) 本公司擁有人應佔每股未經審計[編纂]經調整綜合有形資產淨值乃根據已發行股份[編纂]股(假設[編纂]已於2023年12月31日完成，但不計及因行使[編纂]而可能配發及發行的任何股份或本公司可能發行或購回的任何股份)計算。

我們於科創板上市

自2022年4月起，我們的A股於科創板上市。董事確認，自A股上市以來及直至最後實際可行日期，我們並無重大違反科創板適用規則及其他適用中國證券法律及法規的情況。據董事所深知，概無有關我們於科創板的合規記錄的重大事宜須提請聯交所或[編纂]的潛在[編纂]垂注。我們的中國法律顧問認為，自我們的A股上市以來至最後實際可行日期，我們並無任何重大不符合科創板市場適用規則及其他適用中國證券法律法規之情況。基於獨家保薦人進行的獨立盡職審查及上文我們中國法律顧問的意見，概無任何致使其反對董事就本公司於科創板的合規記錄作出的確認的重大事宜須提請獨家保薦人垂注。

股息及股息政策

在本公司股東或董事(如適用)批准派發股息期間，向股東分派股息確認為負債。於往績記錄期，我們於2022年及2023年分別宣派股息人民幣40.6百萬元及人民幣44.3百萬元。

概 要

根據包括《中華人民共和國公司法》及《上市公司監管指引第3號－上市公司現金分紅(2023年修訂)》及公司章程，我們於任何三個財政年度須支付的累計現金股息應不少於該等三個財政年度按照中國公認會計準則計算可供分派平均淨利潤的30%，惟須確保本公司可持續經營及長期發展不受影響，且並無重大資本開支計劃。未來利潤分配可以採取現金股息或股票股息或現金股息與股票股息相結合的方式進行。任何建議的股息分派均須由董事會酌情決定及經股東大會批准。董事會可於考慮我們的經營業績、財務狀況、運營需求、資本需求、股東利益及董事會可能認為相關的任何其他條件後建議未來的股息分配。

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計將收取[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)。

根據我們的戰略，我們擬將[編纂][編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於增強我們的研發和創新能力；
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於進一步豐富我們的產品組合及擴展下游應用；
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於擴展我們的海外銷售網絡及於海外市場推廣我們的產品；
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於戰略性投資及／或收購，以實現我們的長期增長策略；及
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)預計將用於營運資金及一般企業用途。

有關進一步詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

概 要

[編纂]

[編纂]指[編纂]產生的專業費用、[編纂]及其他費用(例如酌情激勵費)。我們估計[編纂]將約為人民幣[編纂]元(或[編纂]港元，佔[編纂][編纂]總額[編纂]%(假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示[編纂]範圍的中間價)且並無行使[編纂])，其中(i)約人民幣[編纂]元與發行[編纂]直接相關，其後將於建議的[編纂]完成後予以資本化；及(ii)約人民幣[編纂]元預期將於綜合損益表支銷。按性質劃分，我們的[編纂]包括(i)[編纂]約人民幣[編纂]元及(ii)非[編纂]相關開支約人民幣[編纂]元，其中包括(a)法律顧問及申報會計師的費用及開支約人民幣[編纂]元，及(b)其他費用及開支約人民幣[編纂]元。於2022年、2023年及截至2024年9月30日止九個月，我們並無確認任何[編纂]。

近期發展及無重大不利變動

董事已確認，直至本文件日期，我們的財務或經營狀況或前景自2024年9月30日(為我們最近期綜合財務報表截止日期)以來概無重大不利變動，且自2024年9月30日以來，亦無出現任何會對本文件附錄一所載會計師報告所示資料構成重大影響的事件。